三安光电与意法半导体在重庆合资设厂生产碳化硅晶圆

重庆2023年6月8日 /美通社/ -- 6月7日，中国领先的化合物半导体制造平台三安光电与全球排名前列的半导体公司意法半导体联合宣布：双方已签署协议，拟在中国重庆合资建立一个新的8英寸碳化硅器件制造工厂。同时，三安光电将在当地独资建立一个8英寸碳化硅衬底工厂作为配套。

该合资项目公司将由三安光电控股，暂定名为"三安意法半导体(重庆)有限公司"，其中由三安光电全资子公司湖南三安持股51%，意法半导体（中国）投资有限公司持股49%。项目预计投资总额达32亿美元，待监管部门批准后即开工建设，计划于2025年第四季度点火投产，预计将于2028年全面达产，将采用意法半导体的碳化硅专利制造技术，达产后可生产8英寸碳化硅晶圆10,000片/周。三安光电独资在重庆设立的8英寸碳化硅衬底工厂计划投资约70亿元，将利用自有碳化硅衬底技术独立建造和运营，以满足合资工厂的衬底需求，并与其签订长期供应协议。

三安光电总经理林科闯表示："本次合资工厂的建立，将为中国碳化硅市场注入新的力量，我们将充分发挥各自优势，扩大产能供给，有力推动碳化硅器件在市场上的广泛应用，助推新能源汽车行业快速发展。这也体现出三安光电的碳化硅业务已经得到国际客户的充分认可，是我们朝着国际一流的专业碳化硅晶圆代工厂这一目标迈出的重要一步。随着新的合资工厂和衬底工厂建立，我们有信心继续在碳化硅晶圆代工市场占据优势地位。"

意法半导体总裁兼首席执行官Jean-Marc Chery表示："中国汽车和工业领域正朝着电气化方向全速前进，对意法半导体而言，与中国本土的重要合作伙伴一起建立一个专门的晶圆厂，这将帮助我们以最高效的方式满足中国客户不断增长的需求。我们将三安光电未来的8英寸衬底制造工厂、双方新成立的前端合资制造工厂以及在意法半导体在深圳现有的后端制造工厂相结合，将有能力为中国客户提供一个完全垂直整合的碳化硅价值链。此举也是我们继意大利和新加坡的持续重大投资外，进一步扩大全球碳化硅制造业务的重要一步。"

碳化硅赛道非常火热，新能源汽车是碳化硅的主要应用市场之一，也是产业近年来的核心增长引擎。碳化硅材料具有耐高压、耐高温等优势，碳化硅功率器件应用领域广泛，能提升新能源汽车充电效率，实现同等电量更长续航里程，提升整车驾驶性能，解决"充电慢"和"里程短"的双焦虑。据Yole数据，全球碳化硅功率器件市场规模预计将从2021年的10.9亿美元增长至2027年的62.97亿美元，年均复合增长率达34%。这次两家碳化硅行业巨头的合作，备受行业和市场关注。

原文地址：http://www.china-nengyuan.com/news/196403.html